

2026년 6월 업데이트 목록

no	과정구분	대분류	세부분야	과정명
1	이러닝(환급)	직무역량	반도체	반도체 A클래스: 패키징 후공정
2	이러닝(환급)	직무역량	반도체	반도체 A클래스: Fab 운영 및 설비 관리
3	이러닝(환급)	직무역량	크리에이티브	찍고 편집하고 마케팅하라 - 1인 영상 제작
4	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	노트북 LM 실무 활용법과 데이터 보안 가이드
5	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	검색부터 결과 정리까지, 코멧 에이전트로 한 번에 끝내기
6	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	회의록 자동화부터 맞춤 챗봇까지, AI 윤리로 안전하게 사용하기
7	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	ChatGPT로 발표 자료 기획하고 감마로 슬라이드 만들기
8	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	뤼튼과 미리캔버스로 디자인 걱정 없는 PPT 만들기
9	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI를 활용한 문서 자동화 및 데이터 정리
10	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	ChatGPT로 엑셀 반복 업무 자동화하기
11	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI를 활용한 데이터 시각화하기
12	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	Gemini로 구글 시트와 설문 자동화하기
13	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	Gemini 캔버스 - 제안서·교육자료 만들기
14	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	Gemini 캔버스 - 코딩없이 앱·웹 화면 만들기
15	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	AI 광고 트렌드와 실무 적용 포인트
16	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	AI 광고 이미지 만들기 - 프롬프트부터 스타일 일관성까지
17	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	AI 광고 영상 만들기 - AI 영상 제작과 오디오 더빙
18	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	AI 광고 영상 만들기 - AI 영상 제작과 음악 제작
19	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	CapCut을 활용한 AI 영상 편집
20	마이크로러닝	직무역량	영업/마케팅	AI 기반 콘텐츠 제작 자동화
21	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI시대 리더십의 전환과 핵심 역량
22	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	리더를 위한 AI 리더러시
23	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	생성형 AI 플랫폼 이해와 리더의 활용 기준
24	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 활용 시장 분석 및 시사점 도출
25	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 활용 커뮤니케이션 시각화 실전
26	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 바이브 코딩을 통한 실행형 리더십
27	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 활용 리더의 업무 혁신
28	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 전환을 이끄는 리더의 로드맵
29	마이크로러닝	공통역량	디지털리터러시	AI 윤리·신뢰·책임 & 리더십 본질
30	마이크로러닝	직무역량	인적자원관리	직장인이 반드시 알아야 할 법적 사고방식
31	마이크로러닝	직무역량	인적자원관리	계약서 작성 시 절대 손해 보지 않는 법
32	마이크로러닝	직무역량	인적자원관리	보고서·메일·회의가 분쟁이 된다 문서와 기록의 법칙
33	마이크로러닝	직무역량	인적자원관리	AI 시대의 법률 리스크 회사에서 AI 쓰다가 사고 나는 포인트
34	마이크로러닝	직무역량	인적자원관리	분쟁이 터졌을 때 신고, 고소 등 노동청 및 노동위원회 실무 대응법
35	숏폼	직무역량	반도체	반도체 제품 생산의 이해
36	숏폼	직무역량	반도체	반도체 산업에서 공정 흐름
37	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 공정의 위치
38	숏폼	직무역량	반도체	반도체 테스트 공정
39	숏폼	직무역량	반도체	반도체 EDS 공정
40	숏폼	직무역량	반도체	반도체 테스트 장비와 기술
41	숏폼	직무역량	반도체	반도체 BIN Map과 주요 불량
42	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 후 테스트 (1)
43	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 후 테스트 (2)
44	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 공정 정의
45	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 일반 흐름

46	숏폼	직무역량	반도체	반도체 어드밴스드 패키징 흐름
47	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키지 실장 방식별 구분
48	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키지 제품 구분 (1)
49	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키지 제품 구분 (2)
50	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Back Grinding 공정
51	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Wafer Sawing 공정
52	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Die Attachment 공정
53	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Wire Bonding 공정
54	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Molding 공정
55	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Marking과 Solder Ball
56	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 신뢰성
57	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 EMI 차폐
58	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 소재
59	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 트렌드
60	숏폼	직무역량	반도체	반도체 WLP 기술
61	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Bump 공정
62	숏폼	직무역량	반도체	반도체 WLCSP 공정
63	숏폼	직무역량	반도체	반도체 WLCSP 구조
64	숏폼	직무역량	반도체	반도체 Solder Bump
65	숏폼	직무역량	반도체	반도체 TSV 개요
66	숏폼	직무역량	반도체	반도체 TSV 공정
67	숏폼	직무역량	반도체	반도체 TSV 적용
68	숏폼	직무역량	반도체	반도체 FoWLP 개요
69	숏폼	직무역량	반도체	반도체 WLP/PLP 비교
70	숏폼	직무역량	반도체	반도체 FoWLP 적용
71	숏폼	직무역량	반도체	반도체 AVP 공정 구분
72	숏폼	직무역량	반도체	반도체 메탈 공정
73	숏폼	직무역량	반도체	반도체 노광 공정
74	숏폼	직무역량	반도체	반도체 세정 공정
75	숏폼	직무역량	반도체	반도체 식각 공정
76	숏폼	직무역량	반도체	반도체 연마 공정
77	숏폼	직무역량	반도체	반도체 전자 산업의 변화
78	숏폼	직무역량	반도체	반도체 AI의 변화
79	숏폼	직무역량	반도체	반도체 산업의 변화
80	숏폼	직무역량	반도체	반도체 AI에 따른 업계 변화
81	숏폼	직무역량	반도체	반도체 전공정의 변화
82	숏폼	직무역량	반도체	반도체 후공정의 변화
83	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 기술의 미래
84	숏폼	직무역량	반도체	반도체 HBM 패키지
85	숏폼	직무역량	반도체	반도체 이종 집적 AI 반도체
86	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 기업 전략
87	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 소재와 장비 기술
88	숏폼	직무역량	반도체	반도체 패키징 직무